



【茨城勤務】 ウエハプロセス技術エンジニア（ドライエッチング） 【55553】

ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社での募集です。 プロセス...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

Job ID

1488651

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Ibaraki Prefecture

Salary

6 million yen ~ 8 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】 初年度 23日 1か月目から ※入社月に付与（但し、入社月により付与日数に変動あり）、詳細はオファー時に確認。 【...

Refreshed

October 10th, 2024 03:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2180210】

- 担当技術分野
ドライエッチング技術
- 対象デバイス
150mm~200mm (SiCパワーデバイス)
- 担当業務
 - ・ SiCパワーデバイス向けドライエッチング技術開発（装置選定導入/エッチング条件構築）
 - ・ Siデバイス向けドライエッチング技術開発（装置選定導入エッチング条件構築等）
 - ・ 生産技術開発（生産性改善・歩留まり向上・コストダウン及びBCM推進等）

Required Skills

[Must]

・ドライエッチングプロセス開発・改善業務の経験を有する方

[Want]

・SiCパワーデバイスのドライエッチング（特にトレンチ形成）における使用設備の導入/評価やプロセス構築経験を有する方

・4年制大学または大学院にて工学、化学、または物理学等を修了しており、半導体工学の知識を有していること

Company Description

ルネサス セミコンダクタ マニュファクチャリング株式会社は、ルネサス エレクトロニクス株式会社の完全子会社として、半導体前工程製造事業を担い、国内4工場（那珂工場、川尻工場、西条工場、高崎工場）の運営を統括しています。